

# Progetto per la creazione di un reparto SMT "SURFACE MOUNT TECHNOLOGY" - Reparto montaggio e assemblaggio

## Descrizione del progetto

L'investimento programmato prevedeva l'acquisto di un innovativo macchinario dotato di un sistema di movimentazione automatica e la creazione di un'area dedicata al reparto SMT "SURFACE MOUNT TECHNOLOGY" .

## Obiettivi

Due le finalità: 1. innovare la produzione attraverso una PIK&Place automatica per il posizionamento robotizzato di componenti elettronici su PCB e un sistema di movimentazione automatica dei PCB per P&P; 2. creazione di una area dedicata reparto SMT "SURFACE MOUNT TECHNOLOGY" – reparto montaggio e assemblaggio

## Risultati

Grazie agli investimenti descritti realizzati con il contributo della Reg. Emilia Romagna, oggi può da un lato svolgere internamente una fase prima completamente esternalizzata, dall'altro ha aumentato la capacità produttiva, passando da un massimo di 300.000 componenti/mese agli attuali 700.000/mese. Si da atto di aver creato il reparto SMT SURFACE MOUNT TECHNOLOGY realizzando un'area EPA protezione dalle scariche elettrostatiche dedicata.

**Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale**